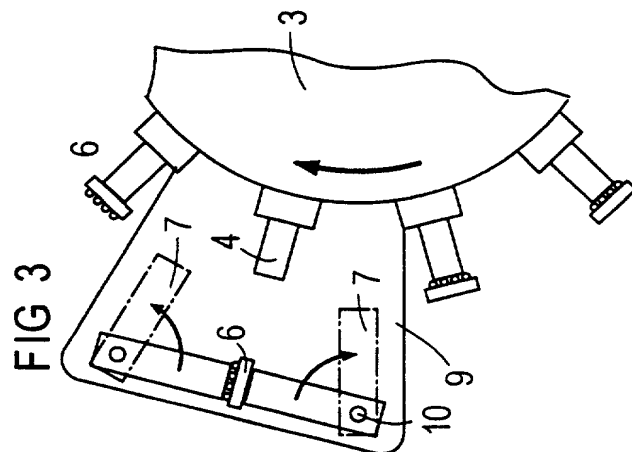
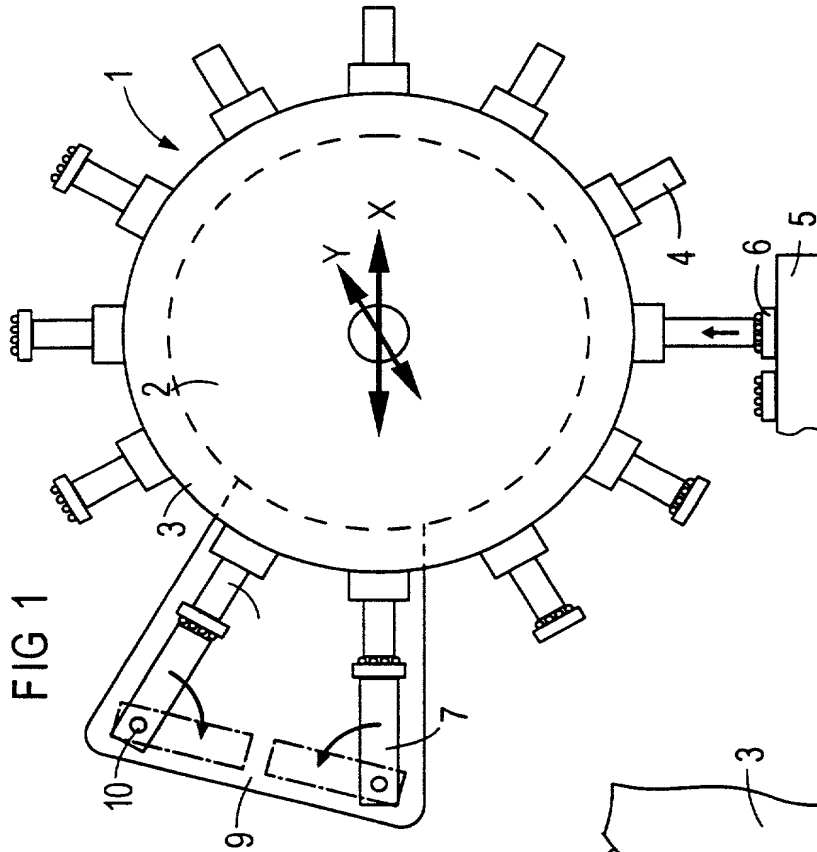
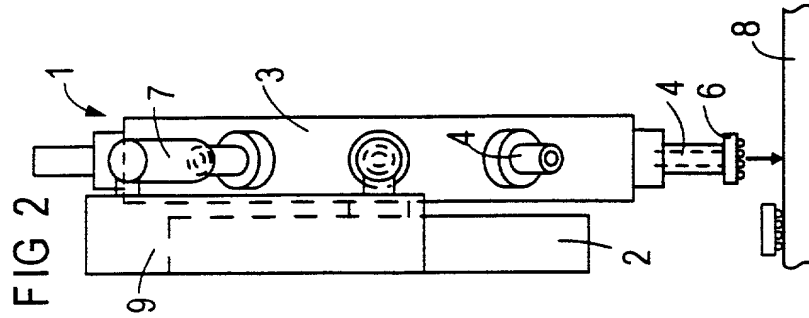


ABSTRACT OF THE DISCLOSURE

5 A freely positionable placement head removes presented flip chips from a wafer with the connection side of said chips being directed upward. The placement head has a turning device, in which, by the time they are placed onto a substrate to be provided with placed components, the flip chips are turned in such a way that they can be placed with their connection side onto the substrate. This makes it possible to dispense with a complex turning device assigned to the wafer.

1/1



Declaration and Power of Attorney For Patent Application
Erklärung Für Patentanmeldungen Mit Vollmacht
German Language Declaration

Als nachstehend benannter Erfinder erkläre ich hiermit
an Eides Statt

As a below named inventor, I hereby declare that:

dass mein Wohnsitz, meine Postanschrift, und meine
Staatsangehörigkeit den im Nachstehenden nach
meinem Namen aufgeführten Angaben entsprechen,

My residence, post office address and citizenship are
as stated below next to my name,

dass ich, nach bestem Wissen der ursprüngliche,
erste und alleinige Erfinder (falls nachstehend nur ein
Name angegeben ist) oder ein ursprünglicher, erster
und Miterfinder (falls nachstehend mehrere Namen
aufgeführt sind) des Gegenstandes bin, für den dieser
Antrag gestellt wird und für den ein Patent beantragt
wird für die Erfindung mit dem Titel:

I believe I am the original, first and sole inventor (if
only one name is listed below) or an original, first and
joint inventor (if plural names are listed below) of the
subject matter which is claimed and for which a patent
is sought on the invention entitled

**Vorrichtung zum Bestücken eines Substrats
mit Flip-Chips**

deren Beschreibung

the specification of which

(zutreffendes ankreuzen)

(check one)

☒ hier beigelegt ist.

☐ is attached hereto.

☐ am _____ als

☐ was filed on _____ as

PCT internationale Anmeldung

PCT international application

PCT Anwendungsnummer _____

PCT Application No. _____

Eingereicht wurde und am _____

and was amended on _____

Abgeändert wurde (falls tatsächlich abgeändert).

(if applicable)

Ich bestätige hiermit, dass ich den Inhalt der obigen
Patentanmeldung einschliesslich der Ansprüche
durchgesehen und verstanden habe, die eventuell
durch einen Zusatzantrag wie oben erwähnt abgeän-
dert wurde.

I hereby state that I have reviewed and understand the
contents of the above identified specification, inclu-
ding the claims as amended by any amendment refer-
red to above.

Ich erkenne meine Pflicht zur Offenbarung irgendwel-
cher Informationen, die für die Prüfung der vorliegen-
den Anmeldung in Einklang mit Absatz 37, Bundes-
gesetzbuch, Paragraph 1.56(a) von Wichtigkeit sind,
an.

I acknowledge the duty to disclose information which
is material to the examination of this application in
accordance with Title 37, Code of Federal Regula-
tions, §1.56(a).

Ich beanspruche hiermit ausländische Prioritätsvor-
teile gemäss Abschnitt 35 der Zivilprozessordnung der
Vereinigten Staaten, Paragraph 119 aller unten ange-
gebenen Auslandsanmeldungen für ein Patent oder
eine Erfindersurkunde, und habe auch alle Auslands-
anmeldungen für ein Patent oder eine Erfindersurkun-
de nachstehend gekennzeichnet, die ein Anmelde-
datum haben, das vor dem Anmeldedatum der An-
meldung liegt, für die Priorität beansprucht wird.

I hereby claim foreign priority benefits under Title 35,
United States Code, §119 of any foreign application(s)
for patent or inventor's certificate listed below and
have also identified below any foreign application for
patent or inventor's certificate having a filing date
before that of the application on which priority is claim-
ed: